

# LMP シンポジウム 2011

## 「レーザー加工技術の欧州および国内の最新動向」

開催日：平成 23 年 1 月 31 日（月）～2 月 1 日（火）

開催場所：名古屋国際会議場 2 号館 3 階 234 会議室

### 主 催

社団法人 日本溶接協会

### 企 画

レーザー加工技術研究委員会(LMP 委員会)

(Laser Materials Processing Committee)

### 協 賛

(社)溶接学会

(社)レーザー学会

(社)高温学会

(社)日本チタン協会

ステンレス協会

レーザー加工学会

(社)日本金属学会

(社)日本鉄鋼協会

(社)軽金属溶接構造協会

中部レーザー応用技術研究会

レーザー協会

産報出版(株)

(順不同、依頼中含む)

### 〔 開 催 主 旨 〕

近年のレーザー加工機器のめざましい発展にともない、溶接、切断、微細加工など各種のレーザー加工技術の実用化が着実に進んでいます。日本溶接協会 LMP 委員会では、レーザー加工の実用化を念頭に、高出力のレーザー発振器やレーザー加工に関する最新の話題、産業応用の現状と今後の課題と展開等について、2002 年より年 1 回のレーザー加工のシンポジウムを開催して参りました。

今年度は、レーザー機器および加工技術の開発・実用化が進んでいる欧州、特にドイツの動向に注目し、欧州と日本におけるレーザー機器およびレーザー加工技術の最新動向をシンポジウムの主題として取り上げました。1 日目には、実際にドイツの研究機関、レーザー発振器メーカー、レーザー溶接実用現場などを訪問して得た情報やレーザー加工関連の国内外の規格化動向など、LMP 委員会の活動成果を講演として紹介するほか、レーザー発振器および関連機器の最新開発状況に関する講演を国内を代表する各メーカーの方々をお願いしております。また、2 日目には、実際のレーザー加工の実用化状況として、レーザー接合および微細加工に関する講演をそれぞれ著名な専門家をお願いしているほか、見学会として実際に種々のレーザー加工機が稼働している生産現場にご案内いたします。

この貴重な機会をご利用頂き、益々発展するレーザー加工の動向をより正確に把握され、さらなる新技術開発の一助として役立てて頂ければと思い、ここにご案内申し上げます。

第1日目：1月31日（月）

10:30～10:35	開会の挨拶	LMP 委員会委員長 沓名 宗春 氏
<b>セッション1【レーザ加工に関する規格化動向】</b>		司会： 柴田 公博 氏（仙台大専）
10:35～11:05	レーザ加工に関する ISO 規格と規格化検討状況 （レーザ加工関連の ISO 規格と現在の ISO での規格化検討状況の紹介）	(株)レーザックス 荒谷 雄 氏
11:05～11:35	レーザ溶接に関する国内規格化の動向 （レーザ溶接関連 JIS 化検討状況、日本海事協会制定ハイブリッド溶接ガイドラインの紹介）	JFE スチール(株) 木谷 靖 氏
11:35～12:35	昼 食 休 憩（昼食は主催者側で弁当を用意いたします）	
<b>セッション2【欧州レーザ加工動向調査報告】</b>		司会： 木谷 靖 氏（JFE スチール(株)）
12:35～13:20	欧州研究機関でのレーザ加工技術開発動向 （ドイツ研究機関の調査内容紹介）	(株)最新レーザ技術研究センター 沓名 宗春 氏
13:20～14:05	欧州レーザ発振器およびレーザ加工技術の実用動向 （レーザメーカーとユーザーの調査内容紹介）	(株)I H I 山岡 弘人 氏
14:05～14:35	レーザ加工に関する国際会議における発表動向 （2010年開催国際会議の概要、注目発表紹介）	大阪大学 片山 聖二 氏
14:35～14:50	休 憩	
<b>セッション3【国内レーザ機器の最新情報】</b>		司会： 山岡 弘人 氏（(株)I H I）
14:50～15:30	浜松ホトニクス（株）における半導体レーザおよびファイバディスクレーザの開発動向	浜松ホトニクス(株) 宮島 博文 氏
15:30～16:10	4kW ファイバーレーザ加工機の開発	(株)アマダ 迫 宏 氏
16:10～16:50	微細・精密加工用レーザ機器の開発動向	ミヤチテクノス(株) 家久 信明 氏
16:50～17:30	レーザ加工用各種ヘッドの開発	(株)レーザックス 坪井 昭彦 氏

第2日目：2月1日（火）

9:00～9:15	会議場開場	
<b>セッション4【レーザ応用接合技術】</b>		司会： 坪田 秀峰 氏（三菱重工業(株)）
9:15～9:50	自動車車体へのレーザブレイジングの適用	スズキ(株) 岸野 左知生 氏
9:50～10:25	レーザ溶接の実橋への適用	(株)I H I 猪瀬 幸太郎 氏
10:25～10:40	休 憩	
<b>セッション5【レーザ微細加工技術】</b>		司会： 西村 仁志 氏（パナソニック溶接システム(株)）
10:40～11:15	太陽電池製造プロセスにおけるレーザ加工技術	ロフィン・バーゼル(株) 空田 和彦 氏
11:15～11:50	レーザピーニング技術の現状	(株)東芝 佐野 雄二 氏
11:50～12:25	レーザ樹脂溶着技術の最新動向	オリエント化学工業(株) 磯田 明秀 氏
12:25～12:30	閉会の挨拶 および 見学会要領説明	LMP 委員会副委員長 片山 聖二 氏

12:30～13:30	昼食休憩(昼食中に見学先の前田工業殿の紹介をいたします)昼食は主催者側で弁当を用意いたします。
<b>見学会【各種レーザー加工機を適用した生産現場のご紹介】</b>	
13:30～17:00 (バスによる移動:17:45頃名古屋駅で解散)	前田工業株式会社殿 1. 5kW、10kWファイバーレーザーによる溶接 2. KUKA ロボットによる高精度溶接 3. スキャナーによる光走査超高速溶接 4. レーザ微細溶接、レーザー焼入れ、レーザークラディング等を予定しております。

講師及びスケジュールについては、やむを得ない事情により変更になる場合があります。最新情報はホームページにてご確認ください。<http://www.jwes.or.jp/lmp/>

## 〔 開催要領 〕

### 1. 日 時

平成23年1月31日(月) 10:30～17:30  
平成23年2月1日(火) 9:15～17:00

### 2. 定 員

100名(定員になり次第、締切りとさせていただきます)

### 3. 参加料

(テキスト代・弁当代・消費税を含む)

参加日数	会 員	非会員
2日間	15,000円	25,000円
1日のみ	10,000円	15,000円

会員とは、日本溶接協会団体会員会社 <http://www-it.jwes.or.jp/kain/kaindsp.jsp> 参照です。

### 4. 申込要領ほか

- ・添付の参加申込書にご記入の上、FAXにて下記宛先までご送付下さい。
- ・参加料は次の方法でご送金下さい。(銀行振込手数料は、御社にてご負担下さい)

**銀行振込：三井住友銀行 神田駅前支店 普通預金口座 No. 146921 (社)日本溶接協会**

(原則として、銀行口座への振込みをもって領収に代えさせていただきますのでご了承下さい)

- ・振込み後の参加料は返却致しません。欠席の場合は、代理出席をお願い致します。
- ・申込受付後、FAXにて受講券をお送り致します。当日必ずご持参下さい。
- ・テキストは、当日会場受付でお渡し致します。
- ・昼食は主催者側でご用意します。

### 5. 講習会事務局

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 1-11 産報佐久間ビル 9階  
(社)日本溶接協会 業務部 上原、内海(ウチウミ)  
TEL: 03-3257-1524 FAX: 03-3255-5196

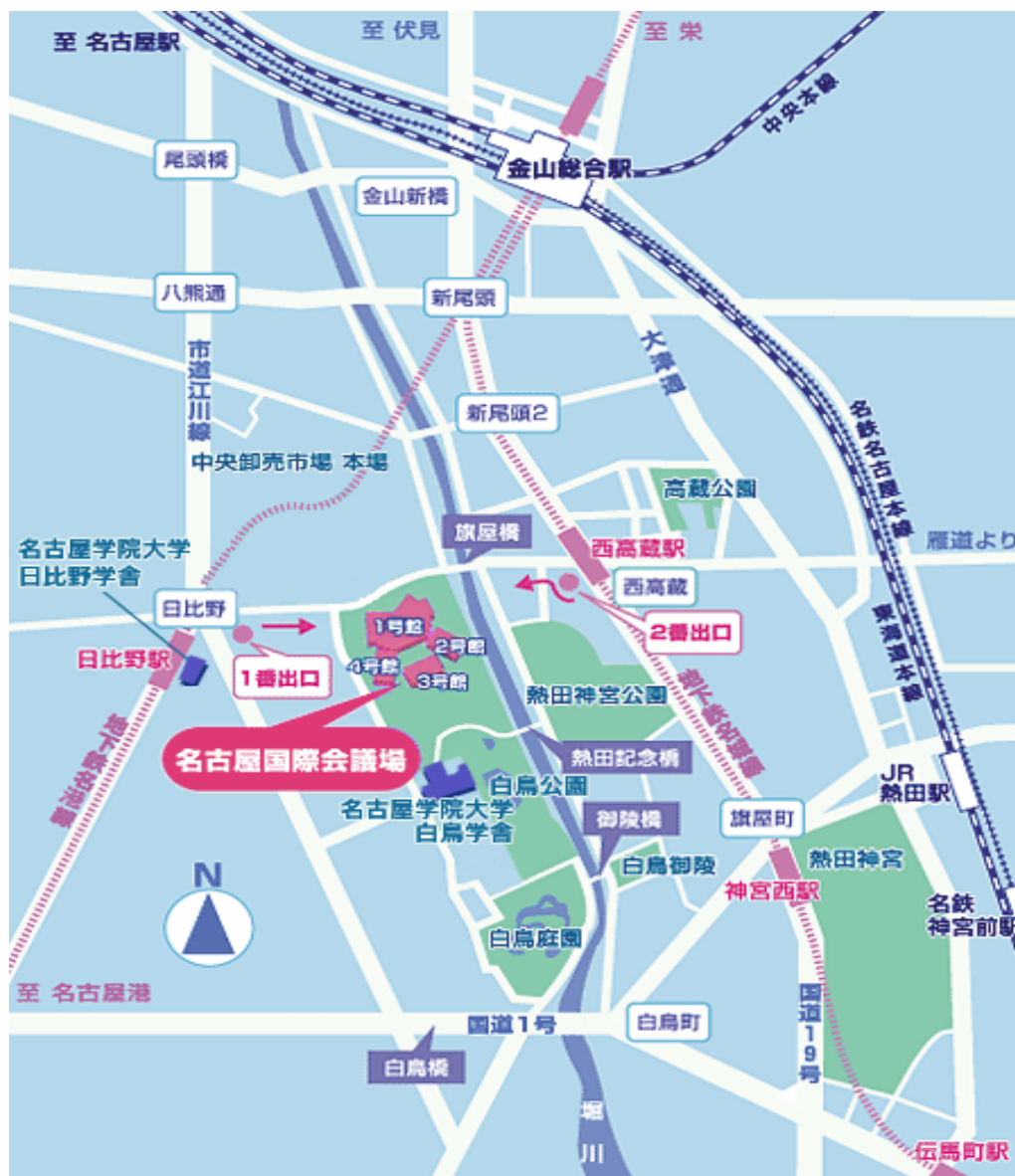
### 6. 会場

会 場：名古屋国際会議場 2号館 3階 234  
住 所：〒456-0036 名古屋市熱田区熱田西町 1-1

交通アクセス：

名古屋駅 近鉄線 JR線 東海道新幹線	タクシー	名古屋駅 → 名古屋国際会議場	約 20分	約 2,000円
	地下鉄	名古屋駅 → 東山線「栄」 桜通線「久屋大通」 のりかえ → 名城線「日比野」下車 → 名古屋国際会議場 「西高蔵」 徒歩約5分	約 20分	地下鉄 230円
中部国際空港 セントレア	名鉄線 + 地下鉄	中部国際空港 → 金山 → 地下鉄2分 名港線「日比野」下車 → 名古屋国際会議場 名城線「西高蔵」 徒歩約5分	約 40分	空港線 1,140円 地下鉄 200円

● 公共交通機関をご利用ください



FAX : 03-3255-5196

日本溶接協会 上原、内海 宛

LMPシンポジウム 2011

「レーザー加工技術の欧州および国内の最新動向」参加申込書

1	フリガナ		
	氏名	(姓)	(名)
勤務先 (会社名・部署)			
同上所在地	〒		
	TEL :	FAX :	
E-mail			
会員・非会員	会 員 ・ 非会員		
参加日数	2日間 ・ 1/31(月)のみ ・ 2/1(火)のみ		

2	フリガナ		
	氏名	(姓)	(名)
勤務先 (会社名・部署)			
同上所在地	〒		
	TEL :	FAX :	
E-mail			
会員・非会員	会 員 ・ 非会員		
参加日数	2日間 ・ 1/31(月)のみ ・ 2/1(火)のみ		

記載頂いた個人情報は「個人情報の保護に関する法律」に則り、弊協会が定めた「個人情報保護方針」に従って管理致します。詳細については日本溶接協会HP <http://www.jwes.or.jp/> をご覧下さい。

参加料：(テキスト代・弁当代・消費税を含みます)

参加日数	会 員	非会員
2日間	15,000円	25,000円
1日のみ	10,000円	15,000円

会員とは、日本溶接協会団体会員会社 <http://www-it.jwes.or.jp/kain/kaindsp.jsp> 参照です。

振込予定日：平成 年 月 日頃

振込金額：¥

・参加料は次の方法でご送金下さい。(銀行振込手数料は、御社にてご負担下さい)

銀行振込：三井住友銀行 神田駅前支店 普通預金口座 No. 146921 (社)日本溶接協会

(原則として、銀行口座への振込みをもって領収に代えさせていただきます。)